Pressemitteilung

**Was steckt hinter den Produkten von SECO auf der embedded World 2022?**

**Hamburg, 16. Mai 2022** - Vom **21. bis 23. Juni 2022** kehrt die embedded world Exhibition & Conference, die internationale Leitmesse für Embedded Technologien, ins Messezentrum Nürnberg zurück.

SECO ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI). Als Austeller ist SECO seit der ersten Embedded World dabei und begrüßt in diesem Jahr **Besucher am Stand 1-320.** Hier stellt SECO sein umfangreiches Portfolio an Embedded Computing, Human Maschine Interfaces (HMI), Kommunikationsgateways, Zahlungssystemen, kundenspezifischen Produkten und IoT-Softwarelösungen vor.

Die Embedded-Produkte von SECO sind das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung in Entwicklung und Fertigung und sind mit modernsten Prozessor-Technologien ausgestattet, die auf x86-, Arm- und FPGA-Architekturen führender Hersteller basieren. Diese Edge-Produkte sind als Computer-on-Module (COM), Single-Board-Computer (SBC), Display-Module sowie als vollständig integrierte und zertifizierte Geräte erhältlich. Die [Clea AI/IoT Suite](https://north.seco.com/produkte-und-services/clea-iot-plattform) ermöglicht eine einfache Integration der Geräte im Feld in die Cloud. Clea ermöglicht Geräteüberwachung in Echtzeit, Analysen, Infrastrukturmanagement, vorausschauende Wartung, sichere Software-Updates (OTA) und vieles mehr. SECO wird auf der embedded world einen Teil seines umfangreichen Portfolios vorstellen.

Die HMI- und Boxed-Lösungen von SECO sind einfach in der Intregration und für industrielle IoT Anwendungen gedacht, wo Flexibilität und Sicherheit entscheidend sind.

Der IoT-Sensor-Access-Point [Easy Edge](https://edge.seco.com/de/easy-edge.html) mit dem Mikrocontroller ESP32-D0WD-V3 bietet mobile Konnektivität (LTE-M/NB-IoT/2G + Wi-Fi, BT) und Geolokalisierungsfunktionen bei geringem Stromverbrauch. Einmal auf einer industriellen oder kommerziellen Maschine integriert und mit [Clea](https://north.seco.com/produkte-und-services/clea-iot-plattform) verbunden, machen KI Algoritmen das Gerät (z.B. eine Kaffeemaschine oder ein Verkaufsautomat) smart. Genau wie Easy Edge können auch alle anderen Hardwareprodukte von SECO mit Clea KI-fähig gemacht werden.

Die FLEXY VISION Produktfamilie bietet sieben HMI-Monitore in verschiedenen Größen (7", 10", 13,3", 15,6" und 21,5") und Prozessorarchitekturen (Arm und x86). FLEXY VISION wurde entwickelt, um spezifische HMI-Anwendungsanforderungen mit exzellenter Grafik, umfangreicher Konnektivität und Flexibilität zu erfüllen. Die intelligenten FLEXY VISION Displays sind vor allem für Anwendungen von Digital Signage bis Infotainment sowie von Verkaufsautomaten bis zur industriellen Automatisierung bestens geeignet. Neben der bekannten FLEXI VISION-Reihe wurde das Produktportfolio um das modulare Proven Concept HMI Portfolio by Garz & Fricke mit Einbauvarianten [Flush Mount](https://edge.seco.com/de/produkte/hmi-losungen/flush-mount/), [Rear Mount](https://edge.seco.com/de/produkte/hmi-losungen/rear-mount/) und [Panel Mount](https://edge.seco.com/de/produkte/hmi-losungen/panel-mount/) sowie den dafür entwickelten Single Board Computern ergänzt.

SECO ist Entwickler und Hersteller von SOMs mehrerer Standard-Formfaktoren und außerdem Mitglied in deren Standardisierungsausschüssen, darunter SMARC, Qseven®, COM-HPC® und COM Express®. Durch die Integration einer SOM-Computing-Plattform in einem kundenspezifisch entwickelten Carrier-Board können sich Produktentwickler auf die einzigartigen Leistungsmerkmale ihrer Anwendung konzentrieren und gleichzeitig eine vollständig entwickelte und validierte Computing-Engine nutzen. Zukünftige Upgrades sind durch den Austausch des COM‘s leicht möglich und SECO unterstützt ebenfalls Kunden bei der Entwicklung von Carrier-Boards.

Als einer der Gründer des Qseven®-Standards im Jahr 2008 verfügt SECO über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Qseven®-Modulen, sowohl mit Arm- als auch mit x86-Prozessorarchitekturen. Das Qseven® ATLAS SOM, basierend auf der Intel® Atom™ X6000E Serie, Intel® Pentium® und Celeron® N und J Serie (ehemals Elkhart Lake) Prozessorfamilie, bietet bis zu 16 GB on-board LPDDR4-3200 DRAM. ATLAS wird auf standardmäßigen Qseven® Release 2.1 Carrier Boards montiert und ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und geringer Fehlertoleranz erfordern.

Unter den vielen SECO SMARC-Modulen, die auf der Messe vorgestellt werden, können Besucher auch mehr über LEVY erfahren, ein SMARC® Rel. 2.1.1-Modul mit dem i.MX 8M Plus Anwendungsprozessor von NXP. Mit einer neuronalen Prozessoreinheit (NPU) für effizientes maschinelles Lernen, zwei Bildsignalprozessoren und Unterstützung für Computer-Vision-Bibliotheken bietet LEVY mit seinem Arm-Prozessor großartige Technologie für komplexe Vision-, fortschrittliche Multimedia- und industrielle IoT-Anwendungen. LEVY nutzt dafür das stromsparende Design, die Skalierbarkeit und die Flexibilität des SMARC-Formfaktors. Das Modul ist ideal für den Einsatz in Projekten die von Industrial IoT über HMI und Smart Digital Signage bis hin zu Smart City und Home Automation reichen.

Im Einklang mit SECOs Strategie, modernste modulare Embedded-Lösungen anzubieten, hat SECO ebenfalls eine Familie von COM-HPC®-Modulen eingeführt. CARINA ist ein COM-HPC® Client Modul Size A, ausgestattet mit 11th Gen Intel® Core™ und Celeron® (ehemals Tiger Lake-UP3) Prozessoren und Intel® Iris Xe Graphics Core Gen12 GPU, unterstützt bis zu vier unabhängigen Displays. CARINA bietet verbesserte Leistung und Grafik zur Beschleunigung von KI- und Deep-Learning-Workloads in eingebetteten Anwendungsfällen.

Das LAGOON ist ebenfalls ein COM-HPC® Client-Modul der Größe A und verfügt über eine Intel® Iris Xe Graphics Core Gen12 GPU mit bis zu 32 Execution Units (EU) und unterstützt bis zu 4 unabhängige Displays. Entwickelt mit Intel® Xeon® W-11000E Series, Core™ vPro® und Celeron® (ehemals Tiger Lake-H) Prozessoren der 11. Generation, sorgt es für sicheres High-Performance-Computing und Interoperabilität für KI, Video und andere datenintensive Anwendungen im Edge-Bereich.

Das dritte Modul in SECOs COM-HPC®-Produktfamilie ist ORION, ein COM-HPC®-Client-Modul der Größe A mit Intel® Core™-Prozessoren der 12ten Generation (früher Alder Lake - H-Serie). Dank der außergewöhnlichen Schnittstellenkonnektivität und Flexibilität, die die Prozessoren bieten, kann dieses Board mit mehreren externen Hardware-Beschleunigern und Peripheriegeräten verbunden werden und liefert so eine herausragende Grafik- und Datendurchsatzleistung für die Automatisierung und KI am Arbeitsplatz.

SECO bietet auch eine breite Palette von COM Express®-Modulen an, die eine schnelle und kostengünstige Anpassung mit umfangreichen Funktionen und grafischen Verarbeitungsmöglichkeiten verbinden. COM Express® Module - sowohl Typ 6 als auch Typ 7 - sind in zwei Formaten erhältlich: Compact (3,74 x 3,74 Zoll) - ein guter Kompromiss zwischen hoher Leistung und geringer Größe - und Basic (4,92 x 3,74 Zoll), dessen zusätzliche Platinenfläche zusätzliche Funktionen oder leistungsstärkere Prozessoren ermöglicht.

Ein Bespiel ist OPHELIA. Dieses COM Express® 3.0 Typ 6 Compact Module wird vom AMD Ryzen™ Embedded V2000 SoCs angetrieben. Mit integrierten "Zen2"-CPU und Radeon™-GPU-Kernen mit bis zu sieben Recheneinheiten ist OPHELIA für Anwendungen wie Biomedizin, Digital Signage, Gaming, Info-Kioske und Überwachung gedacht.

Neben den Standard-Formfaktoren bietet SECO mit der [Myon](https://edge.seco.com/de/produkte/modules/myon/) und [Trizeps](https://edge.seco.com/de/produkte/modules/trizeps/)-Reihe by Keith & Koep auch eigene Formfaktoren an, die sich auf besondere Anforderungen im Bereich kleiner IoT- und batteriebetriebenen Handheldgeräten bzw. besonders langer Pin-Kompatibilität fokussieren.

SECOs Portfolio an Arm- und x86-basierten Single-Board-Computern umfasst Lösungen in gängigen Standardformaten wie pico-ITX und 3,5", die sich durch ihre kompakte Größe auszeichnen. Die SBCs bieten eine komplette Computerlösung mit Standardschnittstellen, einschließlich Konnektivität, Video- und USB-Ports, und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen, die niedrige Design-Investitionen und eine minimale Time-to-Market erfordern.

SECO zeigt exemplarisch den JUNO 3.5" SBC, basierend auf dem Rockchip PX30 Mikroprozessor. Mit seinen umfangreichen Konnektivitätsoptionen ist der JUNO ein hochleistungsfähiges und dennoch kostengünstiges SBC, der sich leicht in industrielle Anwendungen integrieren lässt.

Mit dem [SBCSOM](https://edge.seco.com/de/sbc-som.html) by Keith & Koep wird außerdem eine ganz spezielle Lösung ausgestellt. Dies ist die weltweit erste Lösung, die die Vorteile aus den beiden Produktwelten Single Board Computer (SBC) und System on Module (SOM) vereint, indem es ein Prozessormodul um grundlegende Komponenten und Schnittstellen ergänzt.

Diese und viele weitere Innovationen erwarten die Besucher am **SECO-Stand 1-310/1-320** auf der embedded world 2022, die **vom 21. bis 23. Juni in Nürnberg** stattfindet.

***Über SECO Northern Europe***

*SECO Northern Europe entwickelt und produziert erstklassige, an die jeweiligen Kundenforderungen angepasste Embedded-Systeme. Das Portfolio reicht von Single Board Computern, System On Modules, Human Maschine Interfaces bis hin zu vollständig maßgeschneiderten integrierten Systemen sowie Zahlungssystemen. Durch zusätzliche Lösungen für die Datenverarbeitung an der Edge und in der Cloud, macht das Unternehmen seinen Kunden zukunftsweisende technologische Lösungen auf einfachste und schnellste Weise zugänglich. Ein wichtiger Zukunftsaspekt ist dabei die Integration von KI in alle relevanten Entwicklungen. Kunden sind insbesondere OEMs und Systemintegratoren aus den Zielmärkten Verkaufsautomaten, Medizin- und Labortechnik, Kaffee- und Gastronomietechnik, Sicherheitstechnik und Industrieautomation.*

*Das Unternehmen ist aus der Übernahme der Garz & Fricke Group durch den börsennotierten, italienischen Embedded-Spezialisten SECO (IOT.MI) entstanden. SECO beschäftigt weltweit über 800 Mitarbeiter und verfügt über 5 Produktionsstätten, 9 F&E-Zentren und Vertriebsbüros in 9 Ländern.*

*SECO Northern Europe vertritt die SECO-Unternehmensgruppe im nordeuropäischen Markt inklusive der deutschsprachigen DACH-Regionen und vereint ein unübertroffenes Produkt- und Dienstleistungsportfolio mit der Unternehmensstärke eines an der Börse notierten Vorreiters für IoT und KI-Lösungen. So schafft das Unternehmen spürbare Mehrwerte für seine Kunden. Hauptsitz der SECO Northern Europe ist Hamburg.*

*Weitere Informationen unter:* [*north.seco.com*](file:///\\files.hamburg.garz-fricke.de\z\Marketing\_Public\A_CI\1_Unternehmenstexte\Aktuelle%20Boilerplates\Noch%20nicht%20final\north.seco.com)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ihr Kontakt für Presse und Marketing:  
Steven Kluge

Director Marketing

SECO Northern Europe GmbH

Schlachthofstrasse 20

21079 Hamburg

Direct: +49 40 791899 – 267

E-Mail: [steven](mailto:Garz@garz-fricke.com).kluge@garz-fricke.com

Web: <http://north.seco.com>